



行业动态  
Industry News



### 韩国现代半导体12英寸存储芯片厂完工

2008-09-12 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

韩国现代半导体公司28日表示,该公司位于忠清道清州市的12英寸存储芯片厂已经完工。

韩国现代半导体公司表示,该公司能够加工12英寸晶圆的存储芯片厂已经完工,12英寸晶圆能够以具有竞争力的成本切割更多芯片。

这家位于忠清道(Chungcheong)清州市(Cheongju)的工厂目前拥有一条称为M11的NAND闪存生产线,以后还将拥有一条12英寸晶圆或300毫米晶圆生产线。

已小规模生产NAND闪存的M11生产线计划从9月起开始生产40,000片12英寸晶圆。现代半导体称,这条生产线月产能将在以后升至100,000片以上。

现代半导体在一份声明中称,“生产过时的200毫米晶圆的利润率正在迅速下降。因此,我们将继续使这些设施退役,并同时扩大300毫米晶圆产能。”

现代半导体是按收入计全球第三大NAND芯片制造商,位列三星电子公司(Samsung Electronics Co.)和东芝公司(Toshiba Corp.)之后。

NAND芯片占现代半导体收入的30%左右,而DRAM芯片占到70%左右。

现代半导体称,一旦12英寸晶圆生产线安装完成,这家位于清州的工厂月产能将达到200,000片晶圆以上,从而将该公司12英寸晶圆总产能提升至每月500,000片以上。

(来源:世华财讯 2008年8月28日)

▣ 科普首页

▣ 微电子历史

▣ 行业动态

▣ 术语解释

▣ 无微不至

▣ 芯片制程

▣ 科普创意